

한미반도체

042700

Jul 25, 2022

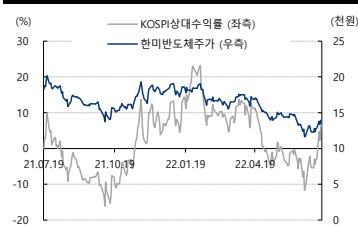
Buy 신규

TP 18,000 원 신규

Company Data

현재가(07/22)	14,400 원
액면가(원)	100 원
52 주 최고가(보통주)	20,150 원
52 주 최저가(보통주)	11,650 원
KOSPI (07/22)	2,393.14p
KOSDAQ (07/22)	789.75p
자본금	127 억원
시가총액	14,244 억원
발행주식수(보통주)	9,892 만주
발행주식수(우선주)	0 만주
평균거래량(60 일)	460 만주
평균거래대금(60 일)	62 억원
외국인지분(보통주)	5.20%
주요주주	
곽동신 외 11 인	55.76%
국민연금공단	6.58%

Price & Relative Performance



주가수익률(%)	1개월	6개월	12개월
절대주가	23.6	-20.3	-26.5
상대주가	21.0	-5.6	-0.2



미드스몰캡 김민철

3771-9253, 20080035@iprovest.com



KYOBO 교보증권

종합 반도체 후공정 장비 Portfolio 구축

종합 반도체 후공정 장비 회사

한미반도체는 종합 반도체 후공정 장비회사로, 대부분 공정에 사용되는 핵심장비 및 보조장비 생산. 글로벌 OSAT 및 PCB업체 등 약 320여개 고객사와 거래하고 있으며, 2021년 micro SAW를 내재화 하여, MSVP에서 높은 매출 성장을 시현.

HMB 성장에 따른 수혜 및 Wafer Saw 시장 진입 전망

TSV용 TC Bonder 수주에 따라 HBM 성장에 따른 수혜 및 고객사 확대 전망. 또한 2022년 까지 Wafer Saw 제품개발을 완료하여 Legacy 패키지용부터 Wafer Saw 시장 진입 전망. Wafer Saw 방식은 현재 동사가 내재화한 Package Saw 방식과 동일한 Blade 방식으로 시장 진입이 용이하고 가시성도 높은 것으로 판단.

2022년 매출액 3,894억원, 영업이익 1,343억원 전망

2022년 매출액 3,894억원(YoY +4.4%), 영업이익 1,343억원(YoY +9.7%) 전망. 동사의 주요고객은 글로벌 OSAT업체이며, 상위 3사향 매출이 동사의 매출비중 약 30~40%를 차지. 2022년 ASE, AMKOR, JCET 합산 Capex 성장폭 둔화에 따라 동사의 매출성장도 4.4% 수준. 영업이익률은 Package Saw 내재화를 증가 및 장비수율 증가에 따라 34%로 높게 유지될 것으로 판단.

목표주가 18,000원으로 커버리지 개시

한미반도체에 대해 투자의견 Buy, 목표주가 18,000원 제시. 2022년 EPS 1,126원에 Target PER 16배를 적용. Target PER 16배는 동사의 과거 2년평균 PER에서 10% 할인. 이는 과거 2년은 동사가 114%, 45%의 높은 매출액 성장율을 보였으나, 2022년 매출액 성장율은 4.4%로 과거 대비 높지 않을 것으로 판단.

Forecast earnings & Valuation

12 결산(십억원)	2020.12	2021.12	2022.12E	2023.12E	2024.12E
매출액(십억원)	257	373	389	447	501
YoY(%)	113.8	45.0	4.4	14.8	12.0
영업이익(십억원)	67	122	134	160	183
OP 마진(%)	26.1	32.7	34.4	35.8	36.5
순이익(십억원)	50	104	111	131	149
EPS(원)	482	1,048	1,126	1,325	1,508
YoY(%)	186.6	117.2	-46.3	17.7	13.8
PER(배)	18.8	18.1	12.8	10.9	9.6
PCR(배)	25.2	25.9	9.1	7.7	6.8
PBR(배)	3.6	5.4	3.3	2.8	2.4
EV/EBITDA(배)	11.7	14.1	9.5	8.0	6.8
ROE(%)	21.0	34.6	28.7	28.2	27.3

1. 기업개요

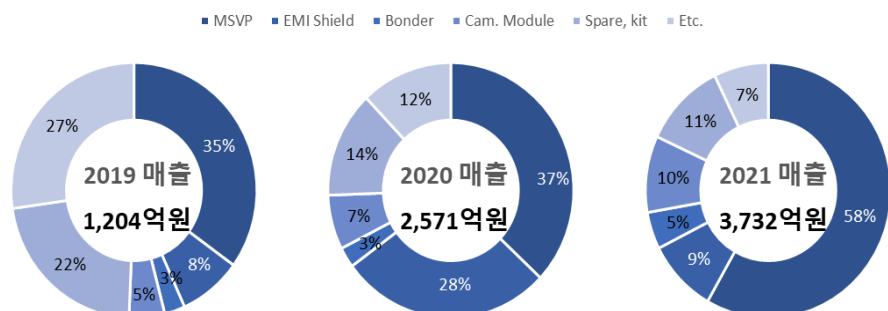
한미반도체는 1980년에 설립된, 종합 반도체 후공정 장비회사이다. 글로벌 OSAT 및 PCB업체 등 약 320여개 회사를 고객사로 두고 있다. 다수의 고객사를 기반으로 반도체 후공정 장비 수를 늘려가며 Portfolio를 갖춰 나가고 있다. 주요 매출은 MSVP에서 발생하고 있으며, 2021년 micro SAW를 내재화하여 높은 매출 성장을 시현하였다. 또한 반도체 패키지 장비 이외 FC-BGA등 PCB용 장비, EMI Shield 및 카메라 모듈 검사장비 라인업도 보유하고 있다.

[도표 1] 한미반도체 주요 연혁

연도	주요내용
1980	한미반도체 설립
1998	VISION PLACEMENT 장비 최초 개발
2005	KOSPI 증권 상장
2017	TSV DUAL STACKING TC BONDER 'IR52 장영실상' 수상
2021	'micro SAW 전용' 공장 오픈 국내 최초 패키지 절단용 'micro SAW' 장비 런칭
2022	micro SAW 'IR52 장영실상' 수상 TechInsights 선정 'THE BEST Award', '10 BEST Award' 수상

자료: 한미반도체, 교보증권 리서치센터

[도표 2] 한미반도체 제품별 매출 추이



자료: 한미반도체, 교보증권 리서치센터

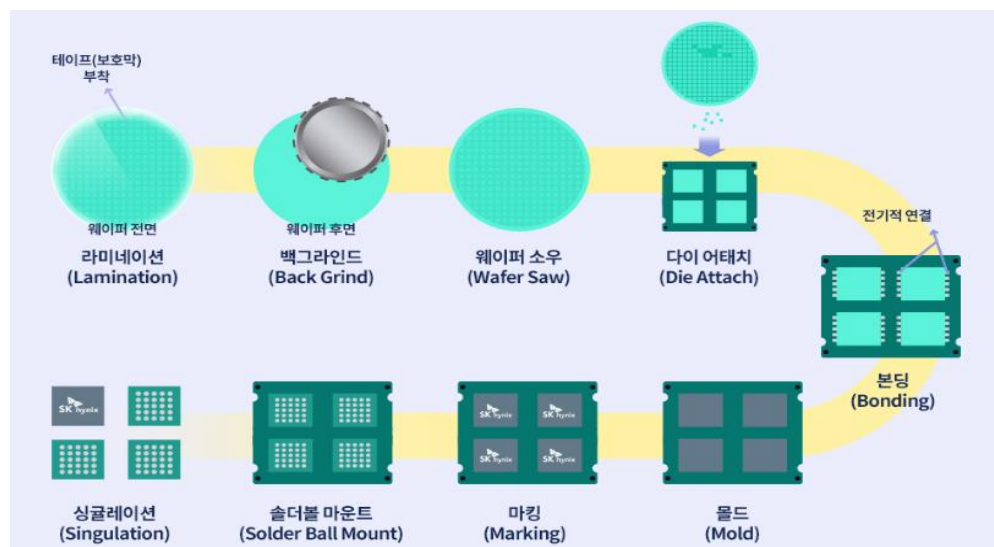
2. 종합 반도체 후공정 장비 기업

2-1. 반도체 패키지란

반도체 공정 중 전공정에서 웨이퍼가 만들어지고, 후공정에서는 그 웨이퍼를 고객이 사용할 수 있도록 패키지를 한다. 최근 반도체 성능개선과 관련하여 비용적으로 전공정에서의 개선(EUV 사용 등에 의한 스케일다운 비용증가)보다 후공정에서의 개선(3차원 적층 등 패키지 구조의 변화)이 효율적이므로 후공정에 대한 중요도가 높아지고 있는 상황이다.

보편적인 패키지 프로세스는(컨벤셔널 서브스트레이트 타입) [도표 3]과 같이 9개의 공정으로 구성되어 있다. 반도체 후공정 장비시장은 현재 디스코, 아크레텍(동경정밀) 등 일본 기업들이 주를 이루고 있으며, 한미반도체는 패키지 장비 국산화를 점차 높여가고 있다.

[도표 3] 반도체 패키지 프로세스



자료: SK하이닉스, 교보증권 리서치센터

패키지 공정은 다음의 순서로 이루어진다. 1) 전공정에서 만들어진 웨이퍼의 전면에 보호막 테이프를 붙이고(라미네이션), 2) 웨이퍼가 쉽게 절단될 수 있도록 웨이퍼 후면을 얇게 연삭하여(백그라인딩), 3) 웨이퍼를 소자 단위로 자른다(웨이퍼 소우). 4) 자른 소자를 기판(서브스트레이트)에 올려 정렬하고(다이어테치), 5) 이후 기판과 소자 사이에 전기가 통하도록 연결하여(본딩), 6) 에폭시로 보호막을 만들어 주고(몰드), 7) 보호막 위에 로고 등을 표시한다(마킹). 8) 이후 솔더볼을 올려 리플로우 작업을 하고(솔더볼 마운트), 9) 잘라서 패키지를 완성한다(싱귤레이션).

2-2. 종합 반도체 후공정 장비회사로 Portfolio 구축 중

한미반도체는 반도체 패키지 공정에 사용되는 핵심장비 및 보조장비 등을 생산하고 있으며, 패키지 장비 Portfolio 구축을 통해 매출성장을 견인하고 있다. 또한 패키지 장비 기술력을 기반으로 FC-BGA 등 PCB용 및 전자파차폐용(EMI Shield) 장비 라인업을 보유하고 있다.

[도표 4] 한미반도체 장비 라인업

분류	공정	한미반도체 장비 라인업	용도
패키지 프로세스용 장비	라미네이션	-	-
	백그라인딩	-	-
	웨이퍼 쏘우	(개발중) Wafer Saw	Blade Dicing 방식의 Wafer Saw 개발 중
	다이어태치	Pick&Place 시리즈	라미네이션공정에서 붙인 테이프를 떼고 검사하는 장비
	본딩	TSV Dual Stacking TC Bonder	TSV 기술이 적용된 HBM을 생산할 때 사용되는 열합착(TC) 본딩장비
		TC Bonder	웨이퍼와 웨이퍼를 열로 합착하는 방식의 본딩장비
		(개발중)Hybride Bonder	범프는 작을수록 유리하며, Hybride Bonder는 범프 없이 웨이퍼 간 직연결
	몰드	Film, Tape Attach	몰딩 전 몰딩소재가 흐르는 것을 방지하기 위한 Taping 장비
		Auto Molding 시리즈	소자를 열경화성 수지로 보호하기 위한 몰딩장비
	마킹	Laser Marking	웨이퍼 또는 패키지 면에 로고 등을 마킹하는 장비
	솔더볼 마운트	Laser Ablation	POP에서 Laser를 이용해 솔더볼이 올라갈 위치를 벗겨내는 장비
	실골레이션	Micor Saw & VP 시리즈	Package 절단>세척>건조>3D 검사>선별>적재 하는 장비
		Laser Cut	메모리 패키지를 Laser를 이용하여 절단하는 장비
	기타	Vision Inspection SECS/GEM	마킹, 불, 리드 등 다양한 검사항목 기능을 갖춘 검사장비 장비 및 공정의 효율화 등 생산라인 자동화를 위한 통신모듈
PCB 용 장비		Micor Saw & VP 시리즈	FC-BGA 등 PCB 절단>세척>건조>3D 검사>선별>적재 하는 장비
자동차용 장비		Flip-Chip 본딩	자동차반도체용 MCU 및 DCU 본딩장비
EMI Shield		6개 장비	테이프 붙이고, 테이프 자르고, EMI Shield 붙이고, EMI Shield 떼고, 테이프 떼고, 검사하는 장비

자료: 교보증권 리서치센터

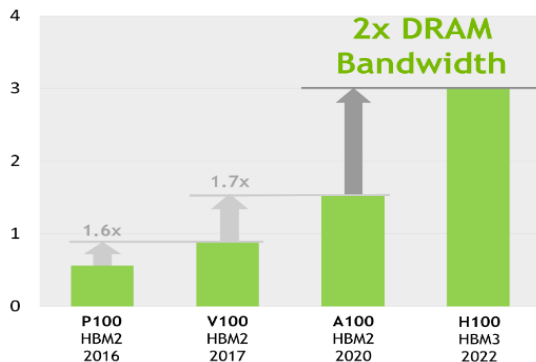
3. HBM3 등 Advanced PKG용 Bonder 기술력 확보

3-1. HBM 이란

HBM(고대역폭메모리)은 GDDR을 대체하기 위해 개발되었다. HBM은 디램을 TSV기술을 이용해 수직으로 적층하여 만들지며, GPU 및 CPU등 시스템과 연결되어 모듈에서 데이터 전송통로 역할을 한다. 삼성전자 및 SK하이닉스에서 만들어지는 HBM은 완제품이 아니며, NVIDIA나 AMD와 같은 시스템 업체로 보내져 Interposer에 시스템 칩을 부착시켜 모듈이 완성 된다.

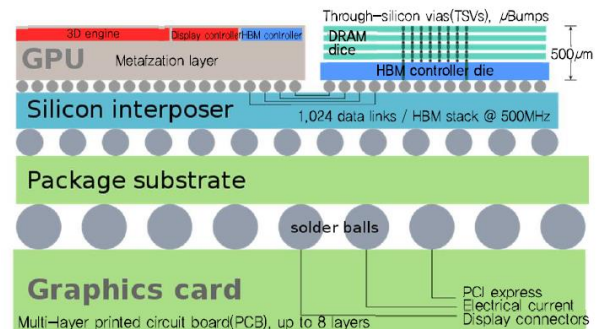
HBM의 장점은 빠른 속도(짧은 레이턴시, 넓은 대역폭)와 낮은 전력소비이다. 완성된 GPU 등은 기후변화해석, 인공지능(AI) 머신러닝을 비롯한 HPC(고성능컴퓨터), 네트워크 등에서 사용된다. 최근 NVIDIA에서 양산 예정인 ‘H100’ 경우 SK하이닉스의 HBM3이 적용되었다.

[도표 5] H100 Delivered Bandwidth TB/s



자료: NVIDIA H100 Tensor Core GPU Architecture, 교보증권 리서치센터

[도표 6] HBM 을 적용한 GPU 메모리모듈



자료: 한국전자통신연구원, 교보증권 리서치센터

3-2. HBM3용 TSV TC Bonder 신규수주

동사는 2022.7. SK하이닉스로부터 HBM3용 TSV TC Bonder 수주를 받았다. 해당 장비는 웨이퍼와 웨이퍼를 붙여주는 TSV용 장비로, TSV 기술은 Advanced PKG에서도 대표적인 첨단 기술이다. 해당 수주는 두 가지 측면에서 긍정적으로 판단된다.

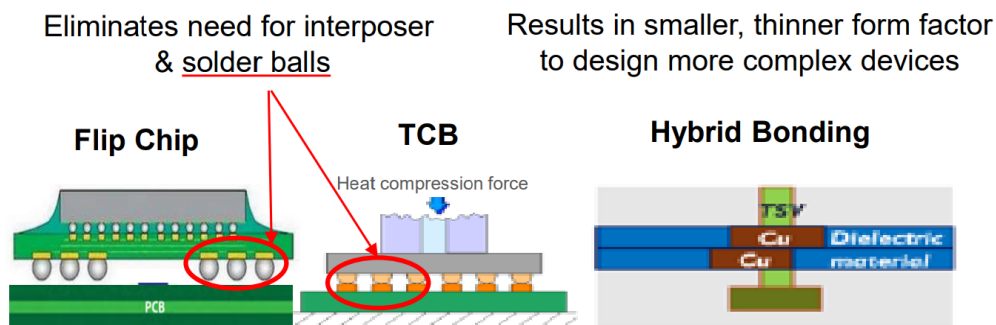
1) HBM 시장 확대에 따른 수혜 전망: HBM은 2013년에 최초 개발 되었으며, HBM3는 4세대이다. 그 동안 HBM은 지속적으로 발전해 왔으나, GPU 등 양산 모듈에 적용되지 못하여 HBM의 성장은 제한적이었다. 최근 NVIDIA에서 양산예정인 GPU모델 ‘H100’에 HBM3이 도입되는 것은 HBM 시장이 확대되는 시발점이 될 것으로 판단된다.

2) TSV용 TC Bonder 기술력 확보에 따른 낙수효과 기대 : 동사의 주요 고객사는 OSAT기업(미들엔드 패키지) 및 일부 파운드리(하이엔드 패키지)기업이다. 동사의 TSV용 TC Bonder는 파운드리(IDM 포함)에 납품하는 하이엔드 패키지용 장비이다. 해당 패키지 기술이 OSAT 기업으로 내려오게 되면 동사의 활동범위가 넓어질 것으로 판단되고, 또한 첨단 패키지용 Bonder 판매에 대한 레코드 및 기술력을 바탕으로 Flip Chip BGA용 Bonder 및 TC Bonder 고객 다변화 측면에서도 긍정적으로 판단된다.

3-3. Hybrid Bonder 개발 중

TSV에 사용되는 범프는 작을수록 성능이 좋아지는데, 왜냐하면 범프가 작을수록 동일한 높이에 더 많은 DRAM의 실장이 가능해지기 때문이다. Hybrid Bonder는 범프 없이 웨이퍼와 웨이퍼를 직접 연결하여 기존 TSV 대비 더 많은 DRAM을 실장하는 패키지 기술이다. Hybrid Bonder시장은 유럽의 패키지장비 기업 BESI社를 중심으로 형성되어 있으며, 동사도 첨단 패키지 트렌드에 맞춰 Hybrid Bonder 개발에 힘쓰고 있다.

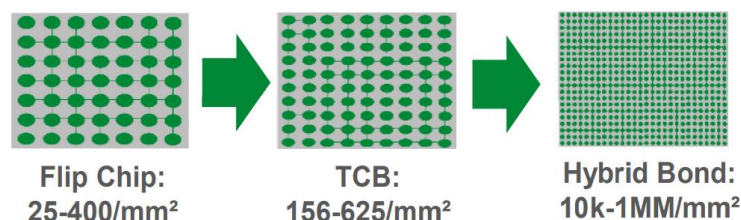
[도표 7] 제품별 연결구조



자료: BESI, 교보증권 리서치센터

[도표 8] 제품별 Bandwidth & Speed

Contact density increased by factor of 1000x by eliminating solder balls, reducing distance between contacts & increasing speed & data transfer



Current design achieves 122 nano placement accuracy at 2,000 uph

자료: BESI, 교보증권 리서치센터

4. Micro Saw 국산화 안착

4-1. Micro Saw 국산화에 따른 점증적 이익 증가

한미반도체는 과거 상플레이션 공정 등에서 사용되는 Vision Placement 위주로 매출이 발생하였다. 그러나 Disco社 Package Saw의 리드타임이 길어짐에 따라 한미반도체는 2021년 하반기 Micro Saw를 내재화하여 국산화하였다.

Micro Saw를 내재화한 지 1년이 지난 현 시점에서 Micro Saw 내재화가 성공적으로 안착된 것으로 판단된다. 이유는 1H22 기준 신규수주의 약 70%가 Micro Saw가 결합된 MSVP장비 형태로 이루어졌기 때문이다. 또한 장비제작에 대한 안정성 증가(수율증가) 및 MSVP 형태의 수주증가로 이익의 점진적 개선이 전망된다.

[도표 9] 한미반도체 Micro Saw & Vision Placement



자료: 한미반도체, 교보증권 리서치센터

4-2. Wafer Saw 개발 중

웨이퍼 절단(Wafer Dicing) 방법은 Blade Dicing (원형 톱), Laser Dicing, Plasma Dicing 방식이 있다. 한미반도체는 Blade 방식의 Wafer Saw를 개발 중에 있으며, 2022년까지 제품개발을 완료하여 Legacy 패키지용부터 Wafer Saw 시장에 진입할 전망이다.

현재 동사가 내재화한 Package Saw는 Blade 방식이 적용되었다. 현재 개발중인 Wafer Saw도 Package Saw와 동일하게 Blade 방식이 적용되는 점, 320여개의 고객사를 확보한 점 등을 고려하여 시장 진입이 용이하고 가시성도 높다고 판단한다.

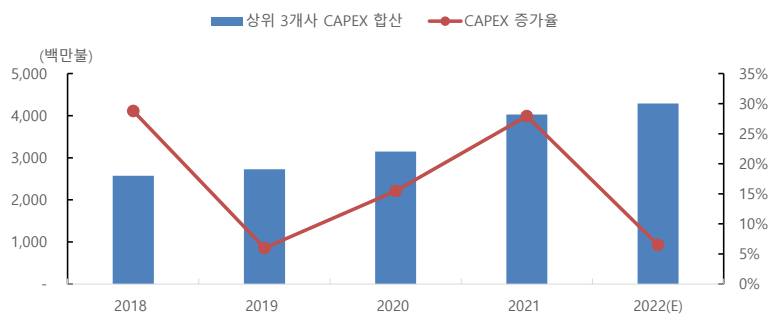
5. 실적전망

5-1. 2022년 매출액 3,894억원, 영업이익 1,343억원 전망

2022년 매출액 3,894억원(YoY +4.4%), 영업이익 1,343억원(YoY +9.7%) 전망된다. 동사의 주요고객은 글로벌 OSAT업체이며, 상위 3사향 매출이 동사의 매출비중 약 30~40%를 차지한다. 2022년 ASE, AMKOR, JCET 합산 Capex 증가율 둔화에 따라 동사의 매출성장도 4.4% 수준으로 전망된다. 영업이익률은 Package Saw 내재화율 증가 및 장비수율 증가에 따라 34%로 높게 유지될 것으로 판단된다.

2023년에는 Intel 및 AMKOR 등 후공정 관련 Capex가 증가할 것으로 보여, 다시 추가적인 높은 성장이 전망된다.

[도표 10] ASE, AMKOR, JCET 합산 Capex 추이 및 전망



자료: Bloomberg, AMKOR, 교보증권 리서치센터

[도표 11] 한미반도체 실적추이 및 전망

(단위 : 억원)

	1Q21	2Q21	3Q21	3Q21	1Q22	2Q22E	3Q22E	4Q22E	2021	2022E	2023E
매출액	709	1,089	917	1,016	632	1,232	958	1,072	3,732	3,894	4,470
YoY	79.0%	75.9%	17.7%	30.4%	-10.9%	13.1%	4.5%	5.5%	45.0%	4.4%	14.8%
매출원가	399	580	473	477	289	627	494	549	1,929	1,959	2,258
매출총이익	310	509	444	539	343	605	465	523	1,802	1,935	2,212
판관비	117	145	134	182	130	166	143	153	578	592	612
영업이익	193	364	309	357	213	439	321	370	1,224	1,343	1,600
YoY	159.8%	81.6%	24.4%	150.2%	9.9%	20.5%	3.9%	3.7%	83.7%	9.7%	19.1%
순이익	204	277	267	297	196	351	279	288	1,044	1,114	1,311
GPM	44%	47%	48%	53%	54%	49%	48%	49%	48%	50%	49%
OPM	27%	33%	34%	35%	34%	36%	34%	35%	33%	34%	36%
NPM	29%	25%	29%	29%	31%	29%	29%	27%	28%	29%	29%

자료: 한미반도체, 교보증권 리서치센터

6. 의견 BUY, 목표주가 18,000원 제시

한미반도체에 대해 투자의견 Buy, 목표주가 18,000원을 제시한다. 목표주가에 대한 밸류에이션은 PER 방식을 적용하였으며, 2022년 EPS 1,126원에 Target PER 16배를 적용하였다. Target PER 16배는 동사의 과거 2년평균 PER에서 10% 할인한 값이다. 이는 과거 2년은 동사의 114%, 45%의 높은 매출액 성장을 보였으나, 2022년 매출액 성장률은 4.4%로 과거 대비 높지 않을 것으로 판단되어 할인하였다.

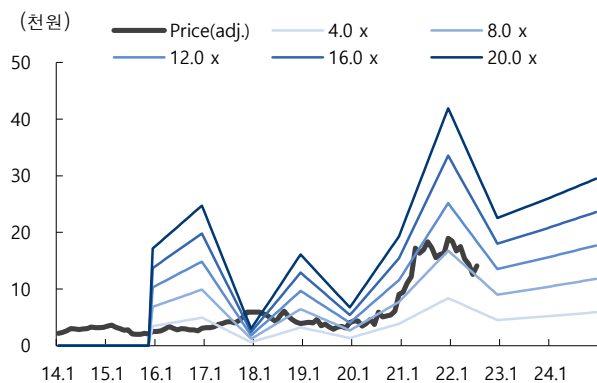
[도표 12] 한미반도체 목표주가 산출

(단위: 원, 배)

	2020A	2021A	2022F	2023F
EPS_당기순이익 기준	482	1,048	1,126	1,294
PER_당기순이익 기준 (End)	38	36	12	10
PER_당기순이익 기준 (High)	38	39	34	30
PER_당기순이익 기준 (Low)	11	16	10	9
PER_당기순이익 기준 (Avg)	21	29	21	19
Target Multiple	16 배			
Target Price	18,000 원			

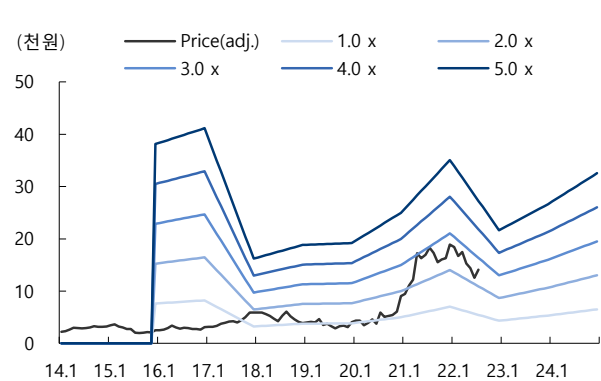
자료: 교보증권 리서치센터

[도표 13] 한미반도체 Fwd P/E 추이



자료: 교보증권 리서치센터

[도표 14] 한미반도체 Fwd P/B 추이



자료: 교보증권 리서치센터

한미반도체 [042700]

종합 반도체 후공정 장비 Portfolio 구축

[한미반도체 042700]

포괄손익계산서

단위: 십억원

12 결산(십억원)	2020A	2021A	2022F	2023F	2024F
매출액	257	373	389	447	501
매출원가	147	193	196	226	252
매출총이익	111	180	194	221	249
매출총이익률 (%)	43.0	48.3	49.7	49.5	49.7
판매비와관리비	44	58	59	61	66
영업이익	67	122	134	160	183
영업이익률 (%)	25.9	32.8	34.5	35.8	36.6
EBITDA	73	129	142	168	192
EBITDA Margin (%)	28.3	34.5	36.4	37.6	38.3
영업외손익	-1	14	11	11	11
관계기업손익	1	6	6	6	6
금융수익	5	12	9	9	9
금융비용	-12	-6	-5	-5	-5
기타	4	1	1	1	1
법인세비용차감전순이익	66	136	145	171	195
법인세비용	16	32	34	40	45
계속사업순이익	50	104	111	131	149
중단사업순이익	0	0	0	0	0
당기순이익	50	104	111	131	149
당기순이익률 (%)	19.5	28.0	28.6	29.3	29.8
비지배자분순이익	0	0	0	0	0
지배자분순이익	50	104	111	131	149
지배순이익률 (%)	19.5	28.0	28.6	29.3	29.8
매도가능금융자산평가	0	0	0	0	0
기타포괄이익	1	-1	-1	-1	-1
포괄순이익	51	104	111	131	149
비지배자분포괄이익	0	0	0	0	0
지배자분포괄이익	51	104	111	131	149

주: K-IFRS 회계기준 개정으로 기존의 기타영업수익/비용 항목은 제외됨

현금흐름표

단위: 십억원

12 결산(십억원)	2020A	2021A	2022F	2023F	2024F
영업활동 현금흐름	37	52	95	97	117
당기순이익	50	104	111	131	149
비현금항목의 가감	25	41	34	40	46
감가상각비	6	6	7	8	8
외환손익	2	-3	-7	-7	-7
자본법평가손익	0	0	-6	-6	-6
기타	17	38	40	46	51
자산부채의 증감	-30	-71	-16	-34	-33
기타현금흐름	-7	-23	-34	-40	-45
투자활동 현금흐름	12	-65	-54	-51	-51
투자자산	0	-37	-37	-37	-37
유형자산	-7	-25	-15	-12	-12
기타	19	-2	-1	-1	-1
재무활동 현금흐름	-15	-20	-30	-59	-59
단기차입금	0	0	0	0	0
사채	0	0	0	0	0
장기차입금	0	0	0	0	0
자본의 증가(감소)	0	0	0	0	0
현금배당	-5	-20	-30	-59	-59
기타	-10	0	0	0	0
현금의 증감	33	-32	30	8	33
기초 현금	48	81	50	79	87
기말 현금	81	50	79	87	120
NOPLAT	51	94	103	123	141
FCF	19	4	79	84	104

자료: 한미반도체, 교보증권 리서치센터

재무상태표

단위: 십억원

12 결산(십억원)	2020A	2021A	2022F	2023F	2024F
유동자산	209	250	289	327	388
현금및현금성자산	81	50	79	87	120
매출채권 및 기타채권	79	113	119	136	152
재고자산	48	86	90	103	115
기타유동자산	1	1	1	1	1
비유동자산	118	180	225	266	307
유형자산	90	108	116	120	124
관계기업투자금	11	55	92	130	167
기타금융자산	3	1	1	1	1
기타비유동자산	14	16	16	15	15
자산총계	327	429	513	593	696
유동부채	68	81	83	90	101
매입채무 및 기타채무	40	45	46	51	56
차입금	0	0	0	0	0
유동성채무	0	0	0	0	0
기타유동부채	28	36	37	39	45
비유동부채	2	2	2	2	3
차입금	0	0	0	0	0
사채	0	0	0	0	0
기타비유동부채	2	2	2	2	3
부채총계	70	82	85	92	104
지배자분	257	347	429	501	592
자본금	13	13	13	13	13
자본잉여금	48	51	51	51	51
이익잉여금	215	283	364	437	527
기타자본변동	-19	0	0	0	0
비지배자분	0	0	0	0	0
자본총계	257	347	429	501	592
총차입금	0	0	1	1	2

주요 투자지표

단위: 원, 배, %

12 결산(십억원)	2020A	2021A	2022F	2023F	2024F
EPS	482	1,048	1,126	1,325	1,508
PER	18.8	18.1	12.8	10.9	9.6
BPS	2,678	3,506	4,332	5,065	5,981
PBR	3.6	5.4	3.3	2.8	2.4
EBITDAPS	1,401	2,586	1,434	1,697	1,938
EV/EBITDA	11.7	14.1	9.5	8.0	6.8
SPS	2,477	3,744	3,937	4,519	5,061
PSR	7.3	10.1	3.7	3.2	2.8
CFPS	371	85	798	851	1,053
DPS	400	600	600	600	600

재무비율

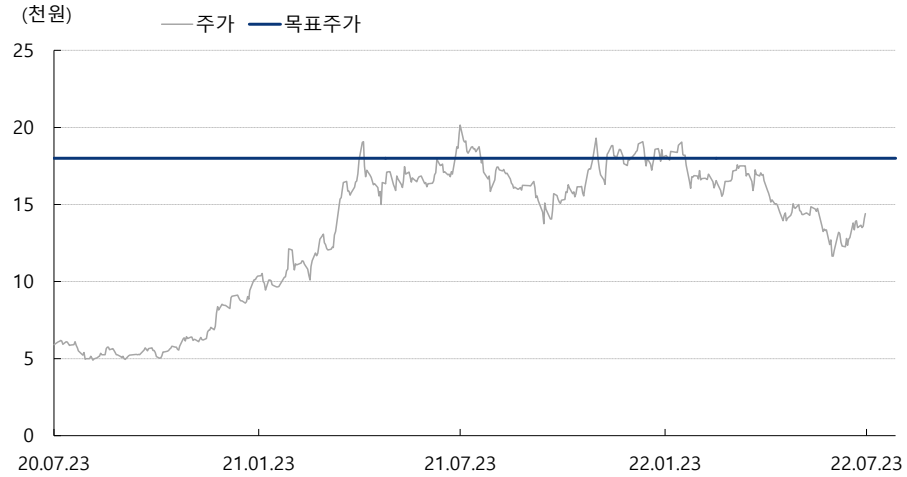
단위: 원, 배, %

12 결산(십억원)	2020A	2021A	2022F	2023F	2024F
성장성					
매출액 증가율	113.8	45.0	4.4	14.8	12.0
영업이익 증가율	385.6	83.7	9.7	19.1	14.7
순이익 증가율	160.3	108.3	6.7	17.7	13.8
수익성					
ROIC	34.2	48.6	42.9	46.8	48.4
ROA	17.2	27.6	23.6	23.7	23.1
ROE	21.0	34.6	28.7	28.2	27.3
안정성					
부채비율	27.2	23.8	19.7	18.4	17.6
순차입금비율	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3
이자보상배율	985.5	3,341.4	3,666.7	4,366.8	5,008.0

한미반도체 [042700]

종합 반도체 후공정 장비 Portfolio 구축

한미반도체 최근 2년간 목표주가 변동추이



최근 2년간 목표주가 및 괴리율 추이

일자	투자의견	목표주가	괴리율 평균 최고/최저	일자	투자의견	목표주가	괴리율 평균 최고/최저
2020.07.25	매수	18,000					

자료: 교보증권 리서치센터

Compliance Notice

이 자료에 게재된 내용들은 작성자의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.

이 조사항목은 당사 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보증하는 것이 아닙니다. 따라서 이 조사항목은 투자참고자료로만 활용하시기 바라며, 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한 이 조사항목의 지적재산권은 당사에 있으므로 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.

- 동 자료는 제공시점 현재 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 전일기준 당사에서 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 추천종목은 전일기준 조사분석 담당자 및 그 배우자 등 관련자가 보유하고 있지 않습니다.

투자의견 비율공시 및 투자등급관련사항 ■ 기준일자_2022.06.30

구분	Buy(매수)	Trading Buy(매수)	Hold(보유)	Sell(매도)
비율	97.5	0.0	2.5	0.0

[업종 투자의견]

Overweight(비중확대): 업종 펀더멘탈의 개선과 함께 업종주가의 상승 기대 **Neutral(중립):** 업종 펀더멘탈상의 유의미한 변화가 예상되지 않음
Underweight(비중축소): 업종 펀더멘탈의 악화와 함께 업종주가의 하락 기대

[기업 투자기간 및 투자등급] 향후 6개월 기준, 2015.6.1(Strong Buy 등급 삭제)

Buy(매수): KOSPI 대비 기대수익률 10%이상
Hold(보유): KOSPI 대비 기대수익률 -10~-10%

Trading Buy: KOSPI 대비 10%이상 초과수익 예상되나 불확실성 높은 경우
Sell(매도): KOSPI 대비 기대수익률 -10% 이하